

2018-2023年中国集成电路封装行业市场发展现状 调查及投资前景规划预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国集成电路封装行业市场发展现状调查及投资前景规划预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/309278309278.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

观研天下发布的《2018-2023年中国集成电路封装行业市场发展现状调查及投资前景规划预测报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及有关部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是为了了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1 集成电路封装行业定义及分类

1.1.1 集成电路封装界定

- (1) 集成电路封装产业概念
- (2) 集成电路封装产业链位置
- (3) 集成短路封装作用，

1.1.2 集成电路封装行业产品分类

- (1) 按功能分类
- (2) 按集成度分类
- (3) 按封装外形分类

1.1.3 集成电路封装行业特性分析

- (1) 行业周期性失灵
- (2) 行业区域性
- (3) 行业季节性

1.2 集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1 行业管理体制

1.2.2 行业相关政策

1.3 集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1 国际宏观经济环境及影响分析

- (1) 国际宏观经济现状
- (2) 国际宏观经济预测

(3) 国际宏观经济环境对行业影响分析

1.3.2 国内宏观经济环境及影响分析

(1) 中国GDP及增长情况分析

(2) 中国工业增加值及增长情况分析

(3) GDP与集成电路封装行业的关联性分析

(4) 居民收入水平

1.3.3 居民收入与行业的相关性

1.4 集成电路封装行业技术环境分析

1.4.1 集成电路封装技术演进分析

1.4.2 集成电路封装形式应用领域

1.4.3 集成电路封装工艺流程分析

1.4.4 集成电路封装行业新技术动态

第二章：中国集成电路产业发展分析

2.1 集成电路产业发展状况

2.1.1 集成电路产业简介

2.1.2 集成电路产业发展现状

2.1.3 集成电路产业运营情况

2.1.4 集成电路产业三大区域分析

(1) 集成电路产业分布特征

(2) 集成电路产业布局发展趋势

(3) 未来集成电路产业空间布局

2.1.5 集成电路产业所遇问题及发展前景

(1) 集成电路产业所遇问题

(2) 集成电路产业发展前景

2.1.6 集成电路产业发展预测

(1) 战略性新兴产业将加速发展

(2) 资本市场将为企业融资提供更多机会

2.2 集成电路设计业发展状况

2.2.1 集成电路设计业发展概况

2.2.2 集成电路设计业行业发展现状

(1) 产业规模持续扩大

(2) 产业结构调整加速

(3) 企业规模加速发展

(4) 技术能力大幅提升

2.2.3 集成电路设计业行业政策分析

2.2.4 集成电路设计业发展策略分析

2.2.5 集成电路设计业“十三五”发展预测

2.3 集成电路制造业发展状况

2.3.1 集成电路制造业发展现状分析

(1) 集成电路制造业发展总体概况

(2) 集成电路制造业发展主要特点

2.3.2 集成电路制造行业规模及财务指标分析

(1) 集成电路制造行业规模分析

(2) 集成电路制造行业盈利能力分析

(3) 集成电路制造行业运营能力分析

(4) 集成电路制造行业偿债能力分析

(5) 集成电路制造行业发展能力分析

2.3.3 集成电路制造行业供需平衡分析

(1) 集成电路制造行业供给情况分析

(2) 集成电路制造行业需求情况分析

(3) 全国集成电路制造行业产销率分析

2.3.4 集成电路制造业“十三五”发展预测

第三章：中国集成电路封装行业发展分析

3.1 中国集成电路封装行业发展历程

3.2 中国集成电路封装行业发展现状

3.2.1 集成电路封装行业规模分析

3.2.2 集成电路封装行业发展现状分析

3.2.3 集成电路封装行业利润水平分析

3.2.4 大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

3.2.5 集成电路封装行业影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

3.2.6 集成电路封装行业发展趋势及前景预测

(1) 发展趋势分析

(2) 前景预测

3.3 半导体封测发展情况分析

3.3.1 半导体行业发展概况

3.3.2 半导体行业景气预测

3.3.3 半导体封装发展分析

- (1) 封装环节产值逐年成长
- (2) 封装环节外包是未来发展趋势

3.4 集成电路封装类专利分析

3.4.1 专利分析样本构成

- (1) 数据库选择
- (2) 检索方式

3.4.2 专利发展情况分析

- (1) 专利申请数量趋势
- (2) 专利公开数量趋势
- (3) 技术分类趋势分布
- (4) 主要权利人分布情况

3.5 集成电路封装过程部分技术问题探讨

3.5.1 集成电路封装开裂产生原因分析及对策

- (1) 封装开裂的影响因素分析
- (2) 管控影响开裂的因素的方法分析

3.5.2 集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

- (1) 产生芯片弹坑问题的因素分析
- (2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第四章：中国集成电路封装市场产品及需求分析

4.1 集成电路封装行业主要产品分析

4.1.1 BGA产品市场分析

- (1) BGA封装技术
- (2) BGA产品主要应用领域
- (3) BGA产品需求拉动因素
- (4) BGA产品市场应用现状分析
- (5) BGA产品市场前景展望

4.1.2 SIP产品市场分析

- (1) SIP封装技术
- (2) SIP产品主要应用领域
- (3) SIP产品需求拉动因素
- (4) SIP产品市场应用现状分析
- (5) SIP产品市场前景展望

4.1.3 SOP产品市场分析

- (1) SOP封装技术
- (2) SOP产品主要应用领域
- (3) SOP产品市场发展现状
- (4) SOP产品市场前景展望
- 4.1.4 QFP产品市场分析
 - (1) QFP封装技术
 - (2) QFP产品主要应用领域
 - (3) QFP产品市场发展现状
 - (4) QFP产品市场前景展望
- 4.1.5 QFN产品市场分析
 - (1) QFN封装技术
 - (2) QFN产品主要应用领域
 - (3) QFN产品市场发展现状
 - (4) QFN产品市场前景展望
- 4.1.6 MCM产品市场分析
 - (1) MCM封装技术水平概况
 - (2) MCM产品主要应用领域
 - (3) MCM产品需求拉动因素
 - (4) MCM产品市场发展现状
 - (5) MCM产品市场前景展望
- 4.1.7 CSP产品市场分析
 - (1) CSP封装技术水平概况
 - (2) CSP产品主要应用领域
 - (3) CSP产品市场发展现状
 - (4) CSP产品市场前景展望
- 4.1.8 其他产品市场分析
 - (1) 晶圆级封装市场分析
 - (2) 覆晶/倒封装市场分析
 - (3) 3D封装市场分析
- 4.2 集成电路封装行业市场需求分析
 - 4.2.1 计算机领域对行业的需求分析
 - (1) 计算机市场发展现状
 - (2) 集成电路在计算机领域的应用
 - (3) 计算机领域对行业需求的拉动
 - 4.2.2 消费电子领域对行业的需求分析

- (1) 消费电子市场发展现状
- (2) 消费电子领域对行业需求的拉动
- 4.2.3 通信设备领域对行业的需求分析
 - (1) 通信设备市场发展现状
 - (2) 集成电路在通信设备领域的应用
 - (3) 通信设备领域对行业需求的拉动
- 4.2.4 工控设备领域对行业的需求分析
 - (1) 工控设备市场发展现状
 - (2) 集成电路在工控设备领域的应用
 - (3) 工控设备领域对行业需求的拉动
- 4.2.5 汽车电子领域对行业的需求分析
 - (1) 汽车电子市场发展现状
 - (2) 集成电路在汽车电子领域的应用
 - (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动
- 4.2.6 医疗电子领域对行业的需求分析
 - (1) 医疗器械制造业发展情况
 - (2) 集成电路在医疗电子领域的应用
 - (3) 医疗电子领域应用前景分析

第五章：集成电路封装行业市场竞争分析

- 5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析
 - 5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况
 - 5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析
 - 5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析
 - (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本
 - (2) 主板材料的变化趋势
 - 5.1.4 国际集成电路封装行业扶持措施借鉴
- 5.2 跨国企业在华市场竞争力分析
 - 5.2.1 台湾日月光集团竞争力分析
 - (1) 企业发展简介
 - (2) 企业组织架构
 - (3) 企业运营情况分析
 - (4) 企业财务情况分析
 - (5) 企业主营产品及应用领域
 - (6) 企业市场区域及行业地位分析

(7) 企业在中国市场投资布局情况

(8) 企业最新动态

5.2.2 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.3 台湾矽品公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.4 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.5 力成科技股份有限公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业主营产品及应用领域

(4) 企业市场区域及行业地位分析

(5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.6 飞思卡尔公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

5.2.7 英飞凌科技公司竞争力分析

(1) 企业发展简介

(2) 企业主营产品及应用领域

(3) 企业市场区域及行业地位分析

(4) 企业在中国市场投资布局情况

5.3 集成电路封装行业国内竞争格局分析

5.3.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析

5.3.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析

5.4 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

5.4.1 现有竞争者之间的竞争

5.4.2 上游议价能力分析

5.4.3 下游议价能力分析

5.4.4 行业潜在进入者分析

5.4.5 替代品风险分析

5.4.6 行业竞争五力模型总结

第六章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析

6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析

6.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名

6.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名

6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析

6.2.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.2 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

- (6) 企业发展能力分析
 - (7) 企业组织架构分析
 - (8) 企业产品结构及新产品动向
 - (9) 企业销售渠道与网络
 - (10) 企业经营状况优劣势分析
 - (11) 企业最新发展动向分析
- 6.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.5 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.6 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 主要经济指标分析
 - (3) 企业盈利能力分析
 - (4) 企业运营能力分析
 - (5) 企业偿债能力分析
 - (6) 企业发展能力分析
 - (7) 企业销售渠道与网络
 - (8) 企业经营状况优劣势分析
 - (9) 企业最新发展动向分析
- 6.2.7 星电子（苏州）半导体有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.8 日月光封装测试（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.9 瑞萨半导体（北京）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.10 英飞凌科技（无锡）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.11 星科金朋（上海）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.12 颀中科技（苏州）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业组织架构分析
 - (4) 企业产品结构及新产品动向
 - (5) 企业销售渠道与网络
 - (6) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.13 天水华天科技股份有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 主要经济指标分析
 - (3) 企业盈利能力分析
 - (4) 企业运营能力分析

- (5) 企业偿债能力分析
 - (6) 企业发展能力分析
 - (7) 企业产品结构及新产品动向
 - (8) 企业销售渠道与网络
 - (9) 企业经营状况优劣势分析
 - (10) 企业最新发展动向分析
- 6.2.14 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.15 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.16 晟碟半导体（上海）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.17 新义半导体（苏州）有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向
 - (4) 企业销售渠道与网络
 - (5) 企业经营状况优劣势分析
- 6.2.18 华润微电子有限公司经营情况分析
- (1) 企业发展简况分析
 - (2) 企业组织架构分析
 - 1) 企业经营情况分析
 - (3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

(6) 企业最新发展动向分析

6.2.19 苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.20 智瑞达科技(苏州)有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.21 大唐微电子技术有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

(6) 企业最新发展动向分析

6.2.22 吴江巨丰电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.23 上海纪元微科电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构及新产品动向

(4) 企业销售渠道与网络

(5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.24 苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业盈利能力分析
- (4) 企业运营能力分析
- (5) 企业偿债能力分析
- (6) 企业发展能力分析
- (7) 企业组织架构分析
- (8) 企业产品结构及新产品动向
- (9) 企业销售渠道与网络
- (10) 企业经营状况优劣势分析
- (11) 企业最新发展动向分析

6.2.25 凤凰半导体通信（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.26 京隆科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

6.2.27 苏州日月新半导体有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 企业销售渠道与网络
- (5) 企业经营状况优劣势分析

第七章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

7.1 集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

- (1) 技术壁垒
- (2) 渠道壁垒

- (3) 人才壁垒
- (4) 市场规模壁垒
- (5) 出口资质壁垒
- 7.1.2 集成电路封装行业盈利模式
- 7.1.3 集成电路封装行业盈利因素
- 7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析
 - 7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况
 - 7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
 - 7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析
 - (1) 通富微电公司投资兼并与重组分析
 - (2) 华天科技公司投资兼并与重组分析
 - (3) 长电科技公司投资兼并与重组分析
 - 7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析
- 7.3 集成电路封装行业投融资分析
 - 7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析
 - (1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况
 - (2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议
 - (3) 大基金对集成电路产业的投资情况
 - (4) 大基金对集成电路产业的投资建议
 - 7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析
 - 7.3.3 半导体行业资本支出分析
- 7.4 集成电路封装行业投资建议
 - 7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析
 - 7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析
 - 7.4.3 集成电路封装行业投资建议
 - (1) 投资区域建议
 - (2) 投资产品建议
 - (3) 技术升级建议

图表目录

图表1：封装在集成电路制造产业链中位置

图表2：集成电路封装行业产品分类

图表3：集成电路封装行业产品分类

图表4：集成电路封装产品按封装外形分类

图表5：2015年我国集成电路封装企业地区分布（单位：%）

图表6：2015年江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元）

图表7：集成电路封装行业主要政策分析

图表8：2016-2017年美国GDP增长率走势（单位：%）

图表9：2016-2017年欧元区GDP增长率（单位：%）

图表10：2016-2017年日本GDP增长情况（单位：%）

图表11：2016-2020年全球宏观经济指标预测（单位：%）

图表12：2016-2017年中国国内生产总值及其增长率（单位：亿元，%）

图表13：2015年我国GDP初步核算数据（单位：亿元，%）

图表14：2016-2017年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%）

图表15：2016-2017年中国GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%）

图表16：2016-2017年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图（单位：元，%）

图表17：2016-2017年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图（单位：元，%）

图表18：集成电路封装技术发展历程

图表19：集成电路封装技术示意图

图表20：集成电路封装技术应用领域

图表21：集成电路封装工艺流程

图片详见报告正文（GY LX）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/309278309278.html>